(Citation 3:)

JP U.M. Application Disclosure No. 58-182444 - Dec. 5, 1983
U.M. Application No. 57-79636 - May 29, 1982

Applicant: Sumitomo Denki Kogyo K.K., Osaka, Japan

Title: Self-power-supply-type IC using light

Detailed Description of the Utility Model:

The IC 1 has a light/electricity conversion part 2 (e.g. silicon solar cell) mounted on the front surface, the back surface, and the partial or entire surface of the side surface (selected on the basis of the required electric power). And, the electric power required for the IC is, in whole or in part, supplied by the light/electricity conversion part 2.

. . . . .

四 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

@ 公開実用新案公報 (U)

昭58—182444

DInt. Cl.3 H 01 L 31/02 識別記号

厅内整理番号 7021-5F

⊕公開 昭和58年(1983)12月5日

審查請求 未請求

(全 1 頁)

図光による自己給電型 I C

の実

顧 昭57-79636

四出

頤 昭57(1982)5月29日

①考案者,角田真治

大阪市此花区岛屋1丁目1番3

砂実用新菜登録請求の範囲

ICパッケージの表面、裏面及び側面の一部ま たは全部に光・電気変換部を装着する、又はIC チップ自体に機能部と前記光・電気変換部を複合 して構成し、酸ICチップを光を導く材料からな るパツケージに組込むことにより散iCが必要と する電力の一部または全部を自己給電することを 特徴とする光による自己給電型IC。

号住友電気工業株式会社大阪製 作所内.

人 住友電気工業株式会社 包田

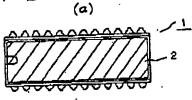
大阪市東区北浜5丁目15番地

弁理士 玉蟲久五郎

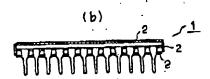
図面の簡単な説明

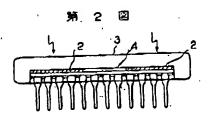
第1図a、b、cは本考案の一実施例のICチ ップの平面図、正面図、側面図、第2図及び第3 図はそれぞれ本考案の実装の他の実施例である。

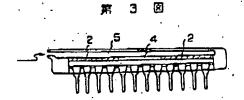
、1 …IC、2 …光・電気変換部、3 …光を導く 材料によるパツケージ、4…従来のIC内部集積 回路、5…光ガイド。











# 公開実用 昭和 58— 182444

ip 日本国特許庁(JP) Li 実用新集出顧公開

12 公開実用新案公報(U)

昭58—182444

St Int. Cl.3 H 01 L 31 02 識別記号

广内整理番号 7021-5F **4**2分開 昭和58年(1983)12月5日

东京流 宋前本

(全 頁)

54 光による自己給電型10

頤 昭57-79636

賴 昭57(1982)5月29日 22 出

21 実

九考 案 省 角田政治 大阪市此花区岛屋1丁目1番3 号住友電気工業株式会社人阪製 作所内

和出 願 人 住友葡萄工業株式会社

大阪市東区北浜5 丁目15番地

九代 理 人 弃理士 玉端久五郎

1 考案の名称

光による自己給電型IC

2. 実用新案登録請求の範囲

1c パッケージの表面、裏面及び側面の一部または全部に光・電気変換部を装着する、又は 1c チップ自体に機能部と前配光・電気変換部を複合して構成し、該 1c チップを光を導く材料からたるパッケージに組込むことにより該 1c が必要とする電力の一部または全部を自己給電力 1c。

3. 考案の詳細な影明

考案の技術分野



## 公開実用 昭和 58─ 182444

#### 技術の背景

従来技術と問題点



使来の IC は必ず電源を外部から供給するため、 実要基板上に電源線を必要とし、このため実装密 酸に制限があり、また複数の電源を必要とする場合が多いため IC の実装が大形化し重い装置となるという欠点があつた。さらに電源用に最少2個 の接続用ビン、場合によつては数個のピンが使用され、機能拡大する IC の入出力信号用のだいない。この信号ピンの不足は、IC の機能を関するいは時分割ピン使用等の複雑を投ががまれた。かつピン数確保のための大形化がられたがあった。加えて外部では、IC の共常により設動作時には破壊がある。外部であるというでは、IC の共常により対象があった。から、一方電源を外部から供給するといら問題があった。

### 考案の目的

本考案は上に述べた近来の欠点を除き、かつ問題点を解決するもので、その目的は 1C パッケーシの表面,要面,側面の一部または全部に光・矩気変換部を装着する、又は 1C チップ自体に光・ 超気変換部を複合して構成することにより、当該 1C の必要とする電力の一部または全部を供給する光による自己給電型 1C を提供することにある。

考察の実施例

第1図(a),(b) 及び(c)はそれぞれ本考案の一実施

(3)

367



### 公開実用 昭和 58—182444

例の実装を示す IC 1 の平面図, 正面図及び側面 図である。 IC 1 の表面、製面、側面の一部また は全部に(所要電力により過択する。)光・電気変 **抑部2(たとえばシリコン太陽電池等)を装置し** JC が必要とする電力の一部または全部を該 ・電気変換部2により供給する。」さらに第2図 及び第3図に示す本考案の他の実施例のように「CC チップ自体に企来の機能部と光・電気変換部2を 複合して作成し、透明なパッケージまたは光ファ イバを埋め込んだパッケージ等光を導く材料によ るパッケージるに組込む。 4 は従来の IC 内部集 傾回路、5は光ファイバなどの光ガイドである。 ② 2 図は上方より光を照射する透明パッ ジ形で 第3回は側方より光を照射する光ガイド内蔵形で ある。光は直接照射または光ファイバを通しての

ا الا الله الا الله

> 以上の構成により本考案の IC は実装基板から in 原線を除き、当該 IC が必要とする電力は電源 ピンを必要とせず光を供給するだけでよく、した がつて外部要因による影響を受けることもない。

照射などで供給する。矢印は光の照射方向を示す。

(4)

### 考案の効果

以上述べたように、本考案によれば実装基板か ら電源線を除くことができるため、基板の有効利 用がはかれ実装密度が増大する、 IC が必要とす る電力を IC 自身が供給するため、光のみ供給す れはよく大形で重い電源装置を必要とせず装置の 小形化、軽減化がはかれる、電源ピンが不要とな るため、蚊少2個のビン、場合によつては数個の ピンの余裕ができる、光により電力を供給できる ため、空間, 僻地など電源供給の困難な物所でも 大規模な設備無しでシステムを動作させることが できシステムの設置範囲の拡大がはかれる、外部 要因に殆んど影響されない光による給電のため、 外部からのノイズによる誤動作、破壊が皆無とな る、さらに+5V,+12V等の IC によつて異なる皆 原を必要とする場合でも、 10 内部で光から電気 に変換する時に任意の角圧を作成すればよく電点 供給は光のみで電源供給パワーの統一化がはかれ るといつた種々の利点があり、 IC を使用する質 子回路全般に適用してその効果大である。



(5)

# 公開実用 昭和 58—182444

### 4. 図面の簡単な説明

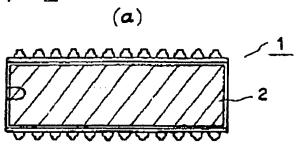
第1回(a),(b),(c)は本考案の一実施例の IC チップの平面図,正面図,側面図、第2図及び第3図はそれぞれ本考案の実装の他の実施例である。

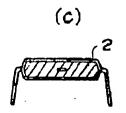
1 … IC 、 2 … 光・電気変換部、 3 … 光を導く 材料によるパッケージ、 4 … 従来の IC 内部集積 回路、 5 … 光ガイド

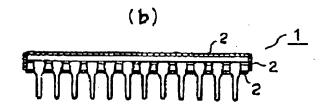


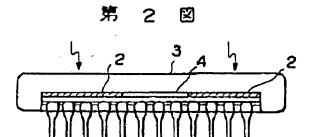
実用新來登録出頗人 住友電気工業株式会社 代理人弁理士 玉 蟲 久 五 郎

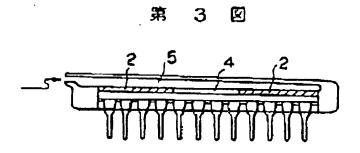












371 実房58-182113